



Unleash Innovation



投遞台積履歷 SOP

2024台積電模組副工程師-校外實習計畫

 小撇步大公開！

Serial number: 202311081000-7887728

掃描QR Code立即應徵

2024台積電模組副工程師-校外學年實習計畫



2024/02/28 前搶得先機

2024校外學年實習 台積電 模組副工程師

實習期間

- 2024/07~2025/06 (暑假+上學期+下學期)

徵才條件

- 專為在校生規劃，對象為大學四年級
- 電機、電子、機械、動機、光電、半導體工程、電通、資工、化材、機電、模具、自動化、飛機、車輛、電輔、機械設計等相關科系
- 具備問題解決、溝通表達、團隊精神、主動學習等能力

工作內容

- 負責半導體產品線機台設備維修及保養
- 管理及改善機台零件系統、包含廠商與下包商之零件備品管理
- 設計機台保養制具及流程改善以增進機台穩定性

福利制度

- 優於同業的整體薪酬，月薪38,000元以上
- 含勞保、健保、團保
- 實習結束後有機會轉正職員工



**2024/02/28
前立即應徵**

上傳必備附件：大學成績單

2024 MAE 模組副工程師 學年實習計畫

工作地點 台灣

專業領域 製造

職別 其它

職務類型 實習

職務張貼日 2023/10/31

線上應徵

分享



最新職缺

[【2024 RDSS&AO】Taiwan_R&D Engineer](#)

[【2024 RDSS&AO】Taiwan_Process Engine...](#)

[【2024 RDSS&AO】Taiwan_Facility Engineer](#)

[【2024 RDSS&AO】Taiwan_MtM RD Engine...](#)

[【2024 RDSS&AO】Taiwan_Process Integr...](#)

職務說明

- 負責半導體產品線機台設備維修及保養
- 管理及改善機台零件系統、包含廠商與下包商之零件備品管理
- 設計機台、保養制具及流程改善以增進機台穩定性
- 實習結業標準：完成新人訓練暨值班考核
- 實習結束後有機會轉正，成為正職MAE員工

職務要求

- 模組副工程師實習計畫是專門為在校所規劃的，對象為大學四年級生，學年實習期間為2024/7-2025/6
- 科系：機械、動機、電機、電子、光電、半導體工程、機電、模具、自動化、飛機、車輛、電輔、機械設計、電通、資工、化材等相關科系尤佳
- 具備解決問題、溝通表達、團隊精神、主動學習等能力
- 能配合在大多數工作時間內，穿著無塵衣且於無塵室環境中工作
- 基本英文讀寫能力



登入

已註冊過帳號?

請使用電子郵件登入您的帳戶

電子郵件

密碼

登入

[忘記密碼了?](#)

台積公司人才招募網站已更新! 凡在2022年7月1日以後沒有更新過履歷的會員帳號, 將不會被遷移至新系統, 需請您於新系統中重新註冊帳號。若您的帳號已成功遷移至新系統, 請點選"忘記密碼"重新設定您的密碼, 即可使用會員帳號原設定的電子信箱重新登入新系統。

請注意: 若輸入密碼達5次錯誤, 您的帳號將會被暫時鎖定。不過別擔心, 使用"忘記密碼"功能即可重新設定, 新密碼設定完成後帳號也會自動解除鎖定。

[← 回到職缺列表](#)

第一次申請

如果您還未建立過帳號, 可以在此建立帳號。

註冊帳號



2024 MAE 模組副工程師 學年實習計畫

選擇申請方式



填寫履歷



上傳履歷



Apply With LinkedIn



2024 MAE 模組副工程師 學年實習計畫

隱私權聲明

本隱私權聲明由台灣積體電路製造股份有限公司及其關係企業（以下共同簡稱為「台積公司」）所提供。本聲明的目的是向申請台積公司職缺或台積公司所設立或共同設立的半導體學程（以下簡稱「半導體學程」）的個人（以下簡稱為「您」）提供隱私權相關資訊。您在申請工作或半導體學程的過程中提供的任何個人資料，將根據適用的個人資料保護法律和法規進行處理，詳細內容請參閱台積公司的隱私權政策，該政策提供英文、中文和日文版本（以下簡稱「隱私權政策」）。台積公司可能會蒐集、處理（包括但不限於以傳真、郵寄或網路傳輸）和使用（以下簡稱為「處理」）您的個人資料，以進行招募、僱傭、人事管理、管理和規劃您申請或參與的特定半導體學程、與您就所申請或參與的半導體學程進行溝通、法律遵循以及建立、行使或保護法律權利，詳細內容請參閱本聲明和隱私權政策。台積公司可能會保存您的個人資料，直到相關目的不存在為止，或在目的消失後繼續保存該資料以符合相關法律的規定，詳細內容請參閱隱私權政策。

關於求職申請，此申請並不構成僱傭契約，若您獲台積公司聘僱時，此申請之內容亦不會決定您與台積公司間僱傭契約的條款和條件。您確認您已閱讀並瞭解本申請中所附的申請說明內容，並確認您對相關問題的回答和陳述是完整且正確的。任何未來的聘僱要約均取決於您在本申請中提供的信息的查證結果。您已瞭解，如果在本申請中發現有虛假陳述、遺漏或錯誤的陳述，可能會導致您的申請被拒絕，或者如果您已經被僱用後，可能因此導致被解僱。

透過提交求職或半導體學程之申請，您同意授權台積公司及其代理人對於您所提供的推薦人資訊和其他任何資訊進行查證。在法律所允許的最大範圍內，您在此放棄請求並解除台積公司及其代理人進行此類資訊查證所產生的任何相關法律責任。台積公司及/或其代理人可能會處理和使用您在申請過程中所提供或未來將提供的任何個人資料（包括敏感個人資料），以用於台積公司的招聘流程和人事管理。

經點擊“我接受”，表示您已閱讀並同意上述所有內容，並聲明您在本申請中所作的陳述均為正確且完整。

取消

我接受

2024 MAE 模組副工程師 學年實習計畫

請輸入以下資料來註冊網站帳號

*姓氏

*名字

*電子郵件

(此Email為登入帳號)

*密碼

您的密碼必須:

- 至少有 12 個字元。
- 有大小寫字母，並且至少有一個數字及一個符號。
- 不包含您的任何個人資訊。

*再次輸入密碼

上一步

註冊

***紅色星星為必填欄位**

密碼必須依照規則

- 12個字以上
- 輸入一個金探號! 或一個@ 或一個#
- 輸入大寫英文+小寫英文 + 數字



2024 MAE 模組副工程師 學年實習計畫

ⓘ 注意, 您目前填入的資訊有誤, 或不符格式規定, 請依照欄位指示更正後, 再送出

請輸入以下資料來註冊網站帳號

* 姓氏

鄭

* 名字

一凡

* 電子郵件

yfchengl@tsmc.com

系統中存在有此資訊的人員

(此Email為登入帳號)

* 密碼

.....

ⓘ 密碼不符合安全要求

您的密碼必須:

- 至少有 12 個字元。
- 有大小寫字母, 並且至少有一個數字及一個符號。
- 不包含您的任何個人資訊。

* 再次輸入密碼

.....

Serial number: 202311081000-7887728

若如果密碼不符
會顯示提醒文字

1 Step 1
個人資料

2 Step 2
工作經驗/學歷

3 Step 3
其它資訊

個人資料

總共3個步驟要寫完

基本資訊

*姓氏	鄧	*名字	一凡
護照英文姓名	Hsiao-Ming		
*國籍	若有多重國籍可以輸入多筆資訊	護照號碼(外籍人士)	
*行動電話	09XXXXXXXX(以利寄送簡訊)	其它電話	
*電子郵件	cyifan3388@gamil.com (此Email為登入帳號)	其它電子郵件	
通訊地址(含郵遞區號)	(300)新竹科學工業園區研新二路6號		

您期望的工作地點

台灣 (台北、新竹、龍潭、竹南、台中、台南、高雄) 中國(上海、南京) 日本 美國 歐洲 我樂於挑戰海外派任之歷練機會

任職於台積公司的親屬/朋友

移除

親屬/朋友姓名

親屬/朋友姓名

關係

部門

新增

兵役狀況

請選擇

*是否曾在台積公司工作? 包含台積公司及其子公司, 例如: WaferTech、JASM等等

請選擇

*您從何得知台積公司職缺訊息

請選擇

請問您是經由台積公司現職員工推薦而來投遞履歷嗎? 若是的話, 請提供此員工之姓名及其公司信箱 是 否

無此項者，
請按**移除**按鈕

*自傳

自傳可填寫

求學經驗/專長/社團/體育長項/個人優勢

工作經驗

無工作經驗者，請點選“移除按鈕”
若您仍為學生，可以填寫實習經驗

**無工作經驗者，
請按**移除**按鈕**

移除

職稱

*職務類型

請選擇

*公司名稱

請選擇

若找不到公司名稱；公司名稱選其它；並填寫其它公司名稱

公司所在地點

在職中

請選擇

*工作-開始

2023年11月



*工作-結束

2023年11月



月薪

新台幣，不含加班費

年薪

新台幣

主要成就

學歷

大學及最高學歷為必填
您必須至少提供兩筆學歷

學歷要填寫兩個

1. 大學(最高學歷勾“是”)

*學校名稱	請選擇	
若搜尋不到您的學校, 請選擇其它並輸入學校名稱		
*學位	請選擇	*科系
就學狀態	請選擇	*最高學歷
		是
		若您仍在“就讀”最高學歷, 請選擇“是”
*在校成績排名	請選擇	
*就學-開始	---年--月	*就學-結束
		---年--月
論文指導教授		論文名稱
論文摘要		

就學結束時間

一定要填2025年/6月

學歷要填寫兩個

2. 高中(最高學歷勾"否")

*學校名稱	請選擇	
若搜尋不到您的學校，請選擇其它並輸入學校名稱		
*學位	請選擇	*科系
就學狀態	請選擇	*最高學歷
		否
若您仍在"就讀"最高學歷，請選擇"是"		
*在校成績排名	請選擇	
*就學-開始	一年-月	*就學-結束
		一年-月
論文指導教授		論文名稱
論文摘要		

語言能力

類別 語言能力(流利程度)

語言考試(成績)

**無語言考試成績者，
請按**移除**按鈕**

考試名稱

*語言考試(成績) *考試日期

證照/證書

移除

證照類別

請選擇



請選擇



證照名稱

取得日期

---年--月



新增

成就

移除

成就類別

請選擇



內容描述

新增

檔案上傳

所有附件檔的檔案大小加總必須小於30MB

您可以檢視「已上傳的檔案」，無需重複上傳已經上傳過的檔案

若您需要上傳多筆檔案或下載/刪除檔案，請使用「我的個人檔案」功能進行相關操作

必要: 上傳 **大三上** 成績單

履歷表

選擇檔案

未選擇任何檔案

成績單

選擇檔案

未選擇任何檔案

語言能力檢定證明

選擇檔案

未選擇任何檔案

證照/證書

選擇檔案

未選擇任何檔案

其它附件

選擇檔案

未選擇任何檔案

暫存

上一步

下一步



Step 1

個人資料



Step 2

工作經驗/學歷



Step 3

其它資訊

資歷查核

請提供至少兩位資歷查核對象，其中一位應包含直屬主管、論文指導教授或是授課老師。若您是應徵技術員職缺，提供一位資歷查核對象即可。

移除

*姓名

*關係

*公司/部門

*職稱

*聯絡電話

*電子郵件

**必要: 請填寫一位老師
為資歷查核對象**

新增

暫存

上一步

確認送出

Serial number: 202311081000-7887728

2024 MAE 模組副工程師 學年實習計畫

謝謝您

您已成功完成申請流程，謝謝您選擇台積公司。如果您符合該職缺的應徵條件，台積公司招募處會盡快與您聯繫。歡迎您隨時回來修改履歷，也建議您定期更新資料。

2024 MAE 模組副工程師 學年實習計畫

台灣

[← 回到職缺列表](#)